

# 中国硅酸盐学会测试技术分会

## 关于召开第十六届无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会的通知 (第一轮)

各相关单位：

为继续推进我国在无机材料结构、性能及测试评价技术方面的研究及应用的不断发展，研讨“十五五”期间无机材料测试技术发展方向，将于2026年10月23-26日在西安召开第十六届无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会（简称TEIM学术年会）。同期还将召开2026年中国硅酸盐学会测试技术分会理事工作会议。

### 一、主办单位

中国国检测试控股集团股份有限公司科学技术协会  
中国硅酸盐学会测试技术分会

### 二、承办单位

西安交通大学  
国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心  
首都科技条件平台中国建材集团研发实验服务基地

### 三、协办单位（征集中）

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)编辑部  
德国耐驰仪器制造有限公司

### 四、会议内容

- 大会报告（邀请中）
- 第四届青年人才能力提升交流会  
形式：ppt宣讲+讨论交流
- 专题报告（召集人征集中）

专题一/召集人：

- A. 传统陶瓷和减摩耐磨材料的结构与性能表征
- B. 高熵陶瓷结构、性能测试与表征
- C. 陶瓷涂层结构、性能测试与表征
- D. 陶瓷增材制造技术与表征技术

专题二/召集人：

- E. 混凝土耐久性表征方法
- F. 水泥混凝土其他性能表征方法

专题三/召集人：

- G. 玻璃的结构与性能表征技术
- H. 玻璃工程安全检测与风险评估

专题四/召集人：

- I. 耐火材料的结构与性能表征
- J. 高温及超高温极端环境下性能测试技术
- K. 高通量测试技术及其他测试新技术

专题五/召集人：

- L. 复合材料结构、性能测试与表征
- M. 航空航天领域结构及材料性能表征与风险评估

## 五、摘要集

- 会议征集论文摘要入编会议手册，截止时间 2026 年 10 月 10 日；
- 请将会议的摘要信息回执（以参会人姓名命名）发邮箱 [ctest2013@163.com](mailto:ctest2013@163.com)；

## 六、会议注册及住宿

### 1、会议注册：

此次会议采用线上注册方式：请扫以下二维码进行报名，或登陆报名系统网址 <https://e3.svipmeeting.com/> 报名。如需预留住宿房间，请务必在报名时勾选。（往届会议注册过的参会人员，不用重复填信息，选注册类型即可直接报名参会。）



## 2、会议注册费：

缴费日期	测试技术分会理事、应邀做邀请报告的代表、参加过近两届研讨会的代表以及学生代表（凭学生证）	其他参会人员
10月 10日之前	1500 元/人	1700 元/人
10月 10日之后	1800 元/人	2000 元/人

❖ 请参会人员注册时，务必填好开发票信息，汇款时备注“参会代表姓名+西安年会”，汇款后及时在注册系统个人中心上传支付凭证或微信通知会务组，会议发票将发送至个人邮箱。

### ❖ 注册费汇款信息：

开户银行：工行北京管庄支行

开户名称：中国国检测试控股集团股份有限公司

账号：0200 0068 0901 4437 256

## 3、报到住宿：

❖ 时间：2026年10月23-26日（23日报到）

❖ 地点：西安市

❖ 协定酒店：陕西世纪金源大饭店

## 七、技术委员会

主任：包亦望

副主任：周延春、江莞、杨健、蒋丹宇

成员（按姓氏拼音排序）：

艾云龙、边华英、曾强、陈大明、陈大博、陈德良、陈伟、陈新春、陈宇红、陈正、邓斌、丁铸、杜强、多树旺、房明浩、冯晶、冯培忠、符秀丽、龚红宇、洪舒贤、胡传林、胡春峰、胡飞、胡劲、黄鹏飞、季伟、赖振宇、李庚英、李江、李强、李维红、李亦然、梁小平、刘斌、刘光明、刘家臣、刘玲、刘世民、刘亦洪、刘志峰、马忠诚、裴强、彭志坚、齐建起、邱海鹏、邱岩、瞿志学、任进军、任小勇、桑绍柏、邵刚、沈宗洋、税安泽、孙庆嘉、谭洪波、汤素芳、唐子龙、

王斌、王京阳、王连军、王荣民、王元生、王占杰、吴赞、向会敏、肖月、熊青香、徐忠根、许钊钊、许杰、叶丽、殷杰、元强、臧博、张骋、张海斌、张建峰、张幸红、张玉军、张祖华、赵海涛、赵升升

#### 八、组织委员会

主任：杨冠军 万德田 孙与康

副主任：张永胜、周春圣、段小明、褚衍辉

成员（按姓氏拼音排序）：（征集中）

秘书处：

测试技术分会：金春霞 18911008610（同微信号）

西安交通大学：刘梅军 18710856387（同微信号）

附件：参会论文摘要信息回执（2026）

本次会议委托北京会视远播文化传媒有限公司负责会务的相关工作

中国检测试控股集团股份有限公司

2026年2月10日

